

Lötkurs - Kurzform

Entnommen: kemo-electronic.com

Die Bauelemente werden gemäß dem Bestückungsdruck auf die Platine gesteckt. Je nach Rasterabstand der Platinenbohrungen müssen die Bauteile "liegend" oder "stehend" montiert werden. Bitte achten Sie beim Biegen der Anschlussdrähte unbedingt darauf, daß diese nicht direkt am Bauelement gebogen werden! Die Bauteile können dann Schaden erleiden! Halten Sie die Drähte mit einer Spitzzange und biegen Sie diese direkt an der Zange, damit keine Biegekräfte in das Innere des Bauteils übertragen werden!

Es darf nur mit einem modernen Elektronik-Lötkolben (15...30 Watt) mit feiner Spitze und kolophoniumhaltigem Elektroniklötzinn auf der Platine gelötet werden! Keine säurehaltigen Flussmittel verwenden! Bevor Lötzinn zugeführt wird, muss zunächst die Lötstelle mit der Lötkolbenspitze aufgeheizt werden. Dabei wird die Spitze so mit leichtem Druck an die Lötstelle gehalten, dass das Lötauge auf der Platine und der Anschlussdraht des Bauteils gleichzeitig aufgeheizt werden. Nach ca. 1...2 Sekunden kann dann, ohne den Lötkolben von der Lötstelle zwischenzeitlich zu entfernen, das Lötzinn zugeführt werden. Das Lötzinn muss sauber um den Draht des Bauelements herumfließen und den Draht ohne Kraterbildung sauber umschließen. Erst dann kann der Lötkolben entfernt werden. Außerdem muß darauf geachtet werden, dass keine "Lötzinnbrücken" zu benachbarten Kupferbahnen oder Lötungen gemacht werden, wenn diese nicht ohnehin leitend mit der Lötstelle verbunden sind. Die gesamte Lötung einer Lötstelle sollte die Zeit von max. 5 Sekunden nicht überschreiten, weil sonst die Bauelemente zerstört werden können. Die häufigsten Fehler beim Löten sind "kalte Lötstellen" und "Kurzschlüsse" durch Zinnbrücken oder nicht abgeschnittene Drahtenden, wenn diese eine benachbarte Lötstelle berühren. Die Lötspitze muß immer sauber und frei von Zunder und Oxyd sein. Die modernen Dauerlötpitzen brauchen nur mit einem feuchten Lappen oder Schwamm abgewischt werden.

